

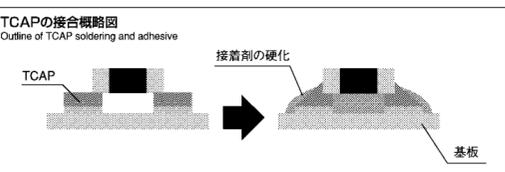
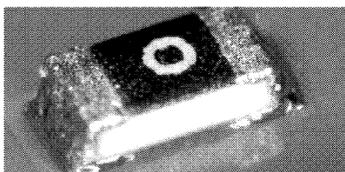
技術革新 & 環境革命



TAMURAの提案

生産現場や商品企画においてCO2削減や、汚染物質の低減など環境対応は重要なテーマです。環境対応とコストの両面からお客様のニーズに応えます。

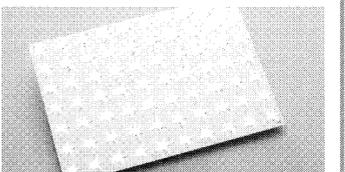
低温作業と無溶剤で環境対応



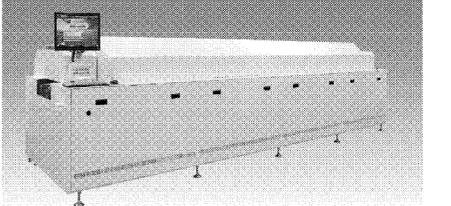
鉛フリー 熱硬化性はんだ接着剤
TCAP-5401-27

●鉛フリー・VOCフリーを実現した環境対応製品 ●はんだ溶融接着と樹脂接着を一括形成
●鉛フリーソルダーペーストより高い接合強度 ●工程の低減が可能(洗浄工程不要)

LED用白色反射材で輝度の向上



RPWシリーズ LED光をより明るく



新型N₂リフロー装置 **TNE25-538EM**

株式会社タムラ製作所

http://www.tamura-ss.co.jp/

●電子化学材料のお問い合わせ先
電子化学事業本部
〒358-8501 埼玉県入間市狭山ヶ原16-2
Tel.04-2934-8134

●はんだ付装置のお問い合わせ先
FAシステム事業部
〒350-1328 埼玉県狭山市広瀬台2-3-1
Tel.04-2955-3111

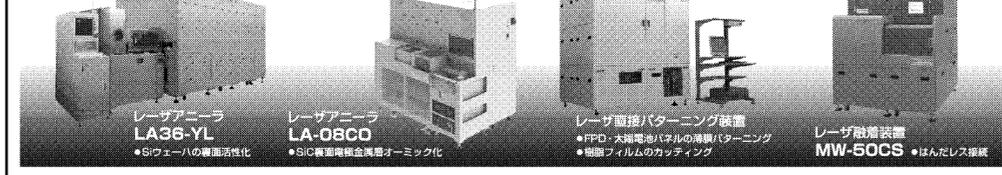
研究開発から量産まで 実装塗布プロセスを大幅革新。

卓上型全自動機!
デスクトップ型 全自動塗布装置
SMART ROBO® TAD-1000

消費電力わずか半分!
高性能 ECO ディスペンサー
SMART SHOT® MS-1 / MS-1D

世界のディスペンサー
武蔵エンジニアリング株式会社
本社 〒181-0013 東京都三鷹市下連雀8-7-4 TEL:0422-76-7111/FAX:0422-76-7122
東京、大阪、名古屋、仙台、福岡、埼玉、長野、東海、東山、金沢 <海外>香港、上海、深圳、大連、韓国、台湾、シンガポール、タイ
www.musashi-engineering.co.jp/ ©2011年1月広告掲載(当社調べ)

最新レーザプロセス for パワーデバイス



インターネット・ジャパン出展 パワーエレクトロニクス技術ゾーン 小間番号:東44-18 2011年1月19日(水)~21日(金) 東京ビッグサイト
株式会社日立ハイテクトレーディング
〒105-8418 東京都港区西新橋一丁目24番14号
TEL:03-3504-6943 FAX:03-3504-7904 http://www.hitachi-hitec-trading.com/

フェトン株式会社 http://www.phoeton.com
〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アストメインタワー 3F
TEL:046-220-2931 FAX:046-220-2903 Mail:info@phoeton.com

エレクトロニクス業界の専門展示会としてはアジア最大級の「ネプコン ジャパン2011」が、19日(水)から21日(金)までの3日間、東京・有明の東京ビッグサイトで開催される。同展は、「第40回インターネット・ジャパン」など7展

示会で構成される国際複合展で、エレクトロニクス製造・実装に関する川上から川下までのあらゆる製品・技術が一堂に集結する。入場料は事前登録者は無料、当日入場者は5000円。開場時間は、10時から18時(最終日は17時終了)まで。

ネプコン ジャパン2011

きょう開幕

21日 金 まで東京ビッグサイトで



第40回 インターネプコン・ジャパン エレクトロニクス製造・実装技術展

アジア最大の専門技術展

1972年に開催されて以来、今回で40回目を迎える「インターネプコン・ジャパン」は、エレクトロニクス製造・実装に関するあらゆる装置、技術、部品・材料が一堂に集まるアジア最大級の専門技術展。会場は東区有明5・6ホール。日本の電気・電子機器業界は高品質と高信頼性を誇る製品開発を展開し、世界に最先端技術を提供してきた。環境配慮の製品対応でも、06年に施行された欧州特定有害物質使用制限(RoHS)指令に代表される有害物質の除去に取り組ん

「1972年に開催されて以来、今回で40回目を迎える「インターネプコン・ジャパン」は、エレクトロニクス製造・実装に関するあらゆる装置、技術、部品・材料が一堂に集まるアジア最大級の専門技術展。会場は東区有明5・6ホール。日本の電気・電子機器業界は高品質と高信頼性を誇る製品開発を展開し、世界に最先端技術を提供してきた。環境配慮の製品対応でも、06年に施行された欧州特定有害物質使用制限(RoHS)指令に代表される有害物質の除去に取り組ん

新たに「精密微細加工技術EXPO」

「精密微細加工技術EXPO」は、エレクトロニクス製造・実装に関する最新の技術、部品・材料が一堂に集まる。会場は東区有明5・6ホール。日本の電気・電子機器業界は高品質と高信頼性を誇る製品開発を展開し、世界に最先端技術を提供してきた。環境配慮の製品対応でも、06年に施行された欧州特定有害物質使用制限(RoHS)指令に代表される有害物質の除去に取り組ん

「精密微細加工技術EXPO」は、エレクトロニクス製造・実装に関する最新の技術、部品・材料が一堂に集まる。会場は東区有明5・6ホール。日本の電気・電子機器業界は高品質と高信頼性を誇る製品開発を展開し、世界に最先端技術を提供してきた。環境配慮の製品対応でも、06年に施行された欧州特定有害物質使用制限(RoHS)指令に代表される有害物質の除去に取り組ん

「アジア最大のエレクトロニクス製造・実装技術展」への関心は高い(前回の会場から、インターネット

「アジア最大のエレクトロニクス製造・実装技術展」への関心は高い(前回の会場から、インターネット

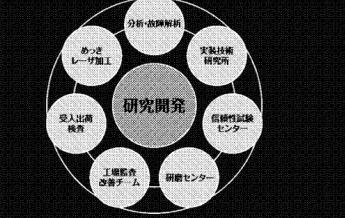
未来品質

不良ゼロの工場・故障ゼロの製品=絶対的品質を追求する「ゼロ思想」に加えて、環境負荷ゼロ・エミッションゼロ・自然を再生する製品づくりを、情報と技術で進化発展させる。それが、クオルテックのトータル・クオリティ・ソリューション活動。たとえば、空気を浄化しながら走行する車、土に還る素材でつくられた携帯電話やゲーム機、遊びを通して健康をチェックできるシステムなど、夢が膨らむものづくりをクオルテックの「未来品質」が実現へと導きます。



分析・信頼性試験のデータに基づき 企業に必要なソリューションを提供。

グローバル化で競争激化する製造業市場。高品質・高機能・高性能はもちろん、スピード経営、コスト管理、安全安心、環境配慮、そして多品種小ロット化など、市場ニーズはますます厳しくなっています。この状況に、それぞれの分野における経験豊富なクオルテックの技術者が対応。研究開発・生産現場・品質に関する情報を収集・提供するとともに、そこから導き出されるソリューションまで、トータルにご提案します。



第28回 エレクトロテスト・ジャパン2011展 クオルテック・技術セミナーのご案内

■会期 2011年1月19日(水)~21日(金)
■場所 東京ビッグサイト内 東展示棟(東4ホール 46-46)

「超安全・エコ社会に向けて 高密度実装技術と信頼性・評価技術についてPartII」を統一テーマとして、クオルテックのブースに於いてお取引各社様の日頃研究されている内容と、弊社が従来から取り組んでいます1000Vマイグレーションやパッケージ基板の熱解析などの研究をはじめ、今回はリチウムイオン2次電池の研究の成果を発表いたします。

第28回 エレクトロテスト・ジャパン2011展 招待講演予定表

1/19 Wed	1/20 Thu	1/21 Fri
10:40~11:00 N品質管理・生産管理の現状と改善策について 11:05~11:25 Fine Pitchはんだ印刷とはんだ付の最新技術 11:30~11:50 スーパーコンピュータからSmarter Planetへ-高密度半導体パッケージング技術がもたらした新たな世界 11:55~12:15 半導体実装ソリューション 12:20~12:40 イオンマイグレーション制御技術 12:45~13:05 構造解析/パッケージ配封技術の紹介 13:10~13:30 リチウムイオン電池のロードマップ 13:35~13:55 半導体パッケージング/半導体パッケージングの最新技術 14:00~14:20 ナンノ機械の分析・評価方法について 14:25~14:45 駆動試験と耐電圧試験について 14:50~15:10 半導体電源装置(LPS)の信頼性評価について 15:15~15:35 プリント配線の電気特性と製造技術 15:40~16:00 Laser Direct Ablation技術について 16:05~16:25 各種材料試験の促進剤半導体 16:30~16:50 フェムトスケール加工技術紹介	10:40~11:00 メソボラスカーボン負極材料の研究 11:05~11:25 構造解析/パッケージング技術の紹介 11:30~11:50 高エネルギー密度と高信頼性を両立させた JEM-2800の紹介 11:55~12:15 絶縁材料の物性評価および信頼性評価方法 12:20~12:40 海外調達/プリント配線板品質保証システム 12:45~13:05 リチウムイオン2次電池電極材料の研究 13:10~13:30 加速する電子部品の品質低下/自分の目でチェックと品質を規定し、独自の品質基準を作ろう 13:35~13:55 高い競争力実現のための検査システム構築 14:00~14:20 スーパーコンピュータからSmarter Planetへ-高密度半導体パッケージング技術がもたらした新たな世界 14:25~14:45 世界最速演算CTによるリチウム電池3次元解析のご紹介 14:50~15:10 スーパーボルト/ファイバレーザー形成の最新技術 15:15~15:35 電気自動車/電気で自動運転車/電気で自動運転車/電気で自動運転車 15:40~16:00 半導体材料の検査/半導体材料の検査/半導体材料の検査 16:05~16:25 各種材料試験の促進剤半導体 16:30~16:50 イオンマイグレーション制御技術	10:40~11:00 各種研究技術の紹介 11:05~11:25 印刷配線の加速試験 11:30~11:50 納入基準の長期信頼性評価方法の開発 11:55~12:15 電圧降下法による高信頼性評価のダイレクト1次試験/コアリング材(INSULJEED)の最新技術 12:20~12:40 各種材料試験の促進剤半導体 12:45~13:05 CoS-1によるCuダイレクト加工技術の紹介 13:10~13:30 MEMS応用から見た信頼性向上について 13:35~13:55 リチウムイオン電池の安全性試験法について 14:00~14:20 世界最速演算CTによるリチウム電池3次元解析のご紹介 14:25~14:45 シミュレーションによる基板耐熱性向上対策 14:50~15:10 実装現場で役立つPBA検査装置 Part II 15:15~15:35 レーザー加工による微小部分の温度計測について 15:40~16:00 技術開発を加速するSMTの対策